

Title (en)  
Heat pump device

Title (de)  
Wärmepumpenvorrichtung

Title (fr)  
Dispositif de pompes à chaleur

Publication  
**EP 2159513 A1 20100303 (DE)**

Application  
**EP 09014427 A 20080223**

Priority  
• EP 08003314 A 20080223  
• DE 102007010139 A 20070228

Abstract (en)  
The heat pump housing has a self-supporting frame composed of vertical (110,150) and lateral (120,130,140,160) struts, to carry covering plates (50,60). The rear wall has a number of openings for connections to the pump components, in a parallelogram layout. Dampers (200) are fitted to the lower lateral struts (120).

Abstract (de)  
Eine Wärmepumpenvorrichtung weist ein Gehäuse auf, welches einen Rahmen aus einer Vielzahl von Streben und Querstreben aufweist, wobei der Rahmen selbsttragend ausgestaltet ist. An dem Gehäuse wird eine Vielzahl von Abdeckblechen (11, 12, 13) vorgesehen, welche an dem Rahmen zur Abdeckung befestigt werden.

IPC 8 full level  
**F25B 30/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**F24F 3/0442** (2013.01); **F24F 13/20** (2013.01); **F25B 30/00** (2013.01); **F25B 2500/13** (2013.01); **F25D 23/006** (2013.01)

Citation (search report)  
• [XY] EP 1598619 A2 20051123 - LG ELECTRONICS INC [KR]  
• [X] US 5839295 A 19981124 - LEHMANN WALTER E [CA]  
• [Y] US 2006080988 A1 20060420 - ZHANG LILI [US], et al  
• [Y] US 4459813 A 19840717 - PETTA JOHN R [US]  
• [Y] FR 2871559 A1 20051216 - FAVIER GEORGES [FR], et al  
• [A] EP 0035656 A1 19810916 - AL KO POLAR MASCHF GMBH [DE]  
• [A] DE 7304418 U 19730524

Cited by  
DE102013204129A1; DE202014002656U1; DE102015001590A1

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1965153 A2 20080903; EP 1965153 A3 20080910; EP 1965153 B1 20101027**; AT E486254 T1 20101115; DE 102007010139 A1 20080904; DE 102007010139 B4 20210211; DE 502008001615 D1 20101209; EP 2159513 A1 20100303

DOCDB simple family (application)  
**EP 08003314 A 20080223**; AT 08003314 T 20080223; DE 102007010139 A 20070228; DE 502008001615 T 20080223; EP 09014427 A 20080223